

证券代码：688439

证券简称：振华风光

贵州振华风光半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别  | <div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> |
| 参与单位名称     | 国泰海通证券股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 时间         | 2026 年 7 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 地点         | 公司五楼会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 上市公司接待人员姓名 | 总会计师、董事会秘书张博学；<br>副总工程师张子扬；<br>董事会办公室主任杨涓禾                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <div>问题 1：公司对于今年业绩是否有明确目标？</div> <div>答：2026 年度，公司将加强关键核心技术攻关、尖端产品研制、先进封装等核心能力建设；深入进行市场、技术趋势分析研判，积极开拓新的市场和业务领域，寻找新的增长点；强化基础管理，提升管理效能，提高运行效率，预计 2026 年营业收入同比去年基本持平。</div> <div>问题 2:请问公司下游客户情况、回款情况？</div> <div>答：公司下游客户群体呈现多元化发展趋势，客户数量呈现稳步增长的趋势。回款方面，针对特定对象客户，会协商制定折扣比例较小的回款折扣方案，具体幅度根据市场行情动态确定，公司始终重视销售回款，采取一系列有效措施，在 2025</div>                    |

年全年实现销售回款 10 亿元，资金回笼成效显著。

**问题 3:公司未来的产品结构与研发布局？**

**答：**公司围绕以放大器、接口驱动、电源管理器、专用转换器、RISC-V 架构 MCU、射频微波芯片六大类产品为“点”，实现各细分领域技术突破；第二，以三大微系统为“面”，重点发展射频微波、电机控制、信号调理系统，推动产品从单一芯片向系统级解决方案升级；第三，以抗辐照核心技术、高宽带环路稳定性设计、超高 PSRR 抑制设计等核心技术为“线”，贯穿全产品谱系。

**问题 4:请问公司特种集成电路是否还存在降价压力？**

**答：**目前特种集成电路价格已呈现较为平稳的状态，趋势趋于平缓。针对产品降价的影响，公司已采取系统性措施：加大研发投入与技术升级、优化产品结构、深化成本管控、提升生产效率、积极布局未来新兴产业，以对冲价格端造成的压力影响。

**问题 5： 请问公司将会在那些领域布局民品市场？**

**答：**2026 年公司将紧盯民品市场领域，积极布局商业航天、低空经济、医疗电子、轨道交通、电力电网等国家战略新兴领域。

**问题 6:请问公司目前在手订单的情况？**

**答：**公司目前在手订单，符合“十五五开局阶段”的整体行业情况。

**问题 7: 请问公司是否布局光模块中的跨阻放大器和 AI 服务器算力芯片？**

**答：**公司目前暂未布局光模块领域的跨阻放大器和 AI 服务器算力芯片的相关技术或产品。未来公司将结合技术发展和市场需求，进一步优化相关产品布局。

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p><b>问题 8：请问公司抗辐照产品推进的情况如何？</b></p> <p>答：面向商业航天领域的高可靠抗辐照产品持续推进中，目前已有十多款产品进入商业航天的选项目录，已有部分订单产生，该赛道竞争对手主要以科研院所为主。</p> <p><b>问题 9：请问公司高可靠晶圆制造及先进封测募投项目的推进情况如何？</b></p> <p>答：公司持续调研国内模拟集成电路晶圆制造行业发展变化，围绕公司“十四五” IDM 产业布局，面向航空航天等领域特种模拟芯片需求优化工艺；依据“十五五”规划构建“3 大系统+6 类产品+1 个核心技术栈”产业体系，着力补齐产业链短板，打通晶圆制造关键环节断点，并同步全面开展工艺技术摸底调研。目前，公司正在按照国家相关产业政策要求，积极寻求申报路径。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 附件清单（如有）              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 日期                    | 2026 年 7 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |